

Accompagnement R&D
Évaluation technologique / fiabilité
Caractérisation Matériaux
→ aide aux choix de conception

Qualité-produit / Qualification
Vérification de la qualité de fabrication
Essais environnementaux sévères
→ validation conformité

Analyse de défaillance
Localisation défaut
Caractérisation physico-chimique
→ identification cause racine

Vos technologies

3 fiches A4 dédiées



PCBA



Composants
Capteurs & MEMS
Passifs, actifs & électromécaniques

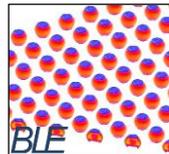


Matériaux d'assemblage / protection
Brasures
PCB, résines & vernis

Techniques & équipements majeurs

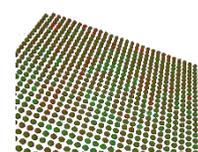
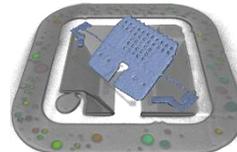
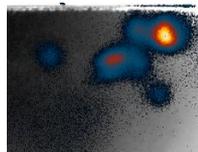
Fiabilité

Simulation numérique
Essais thermiques / climatiques / sous vide
Monitoring électrique in-situ



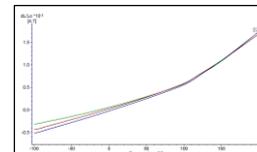
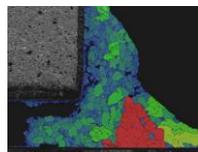
CND

Lock-In Thermo (LIT)
 μ Tomographie X (stat des défauts)
 μ scopie confocale IR (PhEMOS)



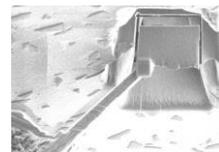
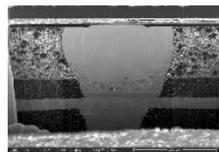
Carac Matériaux

MEB-EBSD
TMA, DSC, DMA
nanoindentation...



Analyses techno

FIB (plasma, Ga)
MEB-EDX (low vaccum ; FEG)



Vos interlocuteurs à ANADEF 2018

Jérémie DHENNIN



Djemel LELLOUCHI



Partenaires

